



2021年2月17日

各 位

上場会社名 メック株式会社
代表者 代表取締役社長 前田 和夫
 (コード番号 4971)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション室 坂本 佳宏
 (TEL 06-6401-8160)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年3月24日に開催予定の第52回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるために現行定款第2条（目的）について事業目的を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. プリント回路基板及び半導体製造過程で基板面に回路を形成する為に使用する工業用薬品の製造、販売並びに輸出入</u> <u>2. 銅、鉄合金、アルミ等各種金属の特殊表面処理技術の開発及びそのノウハウの提供</u> <u>3. 金属と樹脂の密着性向上のための技術の開発及びそのノウハウの提供</u> <u>4. 金属、ガラス、樹脂等の表面改質技術の開発及びそのノウハウの提供</u>	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>(1) 以下の製品の開発、製造、販売および輸出入に係る事業</u> <u>①電子基板・電子部品および半導体の製造過程において用いる表面処理用薬品</u> <u>②前号に関連する材料</u> <u>(2) 電子基板、電子部品および半導体の製造過程において用いる装置および機器の開発、製造、販売、貸与および輸出入に係る事業</u> <u>(3) 金属および樹脂の二次加工</u> <u>(4) 機能性化粧品および医薬部外品ならびにその原料の開発、製造、販売および輸出入に係る事業</u>

現 行 定 款	変 更 案
5. <u>上記2号、3号、4号の技術に関する工業用薬品の製造、販売並びに輸出入</u> 6. <u>プリント回路基板製造装置及び半導体製造装置の設計、製作、据付、販売、リース、賃貸並びに輸出入</u> 7. <u>金属と樹脂の接合部分の製造、販売並びに輸出入</u> 8. <u>鉄、非鉄金属の二次加工</u> 9. <u>工業所有権及び関連ノウハウの開発、取得、実施許諾並びに販売</u> 10. <u>研究調査の請負及び技術コンサルタント</u> 11. <u>前各号に付帯する一切の業務</u>	(5) <u>情報処理・情報提供サービスの運営およびそれらに関するコンサルティング事業</u> (6) <u>広告および宣伝に関する事業</u> (7) <u>農業、林業および水産業に関する事業</u> (8) <u>研究調査の請負および技術コンサルティング事業</u> (9) <u>労働者派遣事業</u> (10) <u>前各号に付帯または関連する一切の事業</u> 【削 除】

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2021年3月24日（水曜日）

定款変更の効力発生日

2021年3月24日（水曜日）

以 上